EDSYN GMBH EUROPA

SSC

bleifreier NO-CLEAN Lötdraht mit Kupfer - eine Garantie für hervorragende Leitfähigkeit

leadfree NO-CLEAN soldering wire with copper - a guarantee for an outstanding power transfer

bleifrei mit Kupfer

leadfree with copper

Der EDSYN Lötdraht SSC mit Kupferanteil ist mit unserem NO-CLEAN Flußmittel nach F-SW 32 versehen.

Dieses NO-CLEAN Flußmittel ist halogenfrei und sorgt für eine gute Verlötung von unterschiedlichsten Komponenten. Die verbleibenden Rückstände sind nahezu durchsichtig.

Neben dem hochpreisigen Silber besitzt Kupfer die höchste Leitfähigkeit.

Über die Legierungsanteile wird ein eutektisches Verhalten erreicht. Ein "Kleben" der Lötstellen wird vermieden. So können fehlerhafte Lötungen verhindert werden.

Technische Daten

● Legierung:	Sn99,3 Cu0,7
● Flußmittel nach:	F - SW 32
● Spulengröße:	250 g, 500 g, 1 kg
● Durchmesser:	0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
● Schmelzpunkt:	+ 227°C (Solidus = Liquidus)

The EDSYN soldering wire SSC with copper is provided with our NO-CLEAN flux according to F-SW 32. This NO-CLEAN flux is free of halogens.

It´s the basis for a solid solder joint which connects different materials. The flux residues are nearly clear.

Aside of the costy silver copper has the highest electric conductivity.

With the special alloy percentage we reach an eutectic performance. A "glueing" of the solder joints is avoided. So faulty solder joints can be prevented.

Technical Data

● alloy:	Sn99,3 Cu0,7
● flux:	F - SW 32
● weight of spool:	250 g, 500 g, 1 kg
● diameter:	0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
● melting temperature:	+ 227°C (Solidus = Liquidus)

EDSYN GMBH EUROPA
Finkenweg 2 • D - 97 892 Kreuzwertheim • Tel. 09342 / 6413
Fax (49) 09342 / 6417 • email: edsyn-europa@t-online.de